

## Press Information

2024年1月4日

ネプコン ジャパン 2024  
第1回パワーデバイス&モジュール EXPO 出展のご案内

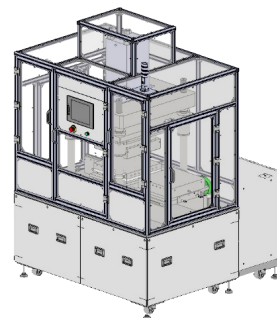
日機装株式会社は 2024年1月24日～26日に開催されるネプコン ジャパン 2024の構成展である、「第1回パワーデバイス&モジュール EXPO」に出展します。本展示会では、研究・開発におけるあらゆる圧着・焼結工程の様々な加圧・加熱条件出しを1台で実現できる「研究・開発用 高機能プレス」をご紹介します。

また、出展社が注目製品をセミナー形式でご紹介する最新技術フォーラムでは、パワー半導体市場の技術動向、日機装の圧着技術（3Dプレス）及びその技術を用いた開発機についてご紹介します。

ぜひ、当社ブースおよびプレゼン会場にお越しください。皆さまのご来場をお待ちしております。

## 開催概要

Web サイト	<a href="https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/about/pdm.html">https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/about/pdm.html</a>
会期	2024年1月24日(水)～1月26日(金)
開催時間	10:00～17:00
会場	東京ビッグサイト
日機装ブース	東4ホール E34-31



## 最新技術フォーラム【出展者セミナー】

タイトル	パワー半導体向け3D技術と開発機のご紹介
日時	2024年1月26日(金) 14:00～14:30 (事前申込み不要)
会場	東6ホール 特設フォーラム会場



## 本件に関するお問合せ先

日機装株式会社 インダストリアル事業本部  
精密機器東京営業第一部 TEL: 03-3443-3780 / 精密機器大阪営業第一部 TEL: 06-6155-2308

以上